

2022-2028年中国射频前端 芯片产业发展现状与市场前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国射频前端芯片产业发展现状与市场前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202209/318532.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2022-2028年中国射频前端芯片产业发展现状与市场前景预测报告》共十一章。首先介绍了射频前端芯片行业市场发展环境、射频前端芯片整体运行态势等，接着分析了射频前端芯片行业市场运行的现状，然后介绍了射频前端芯片市场竞争格局。随后，报告对射频前端芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了射频前端芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对射频前端芯片产业有个系统的了解或者想投资射频前端芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 射频前端芯片基本概述

1.1 射频前端芯片概念阐释

1.1.1 射频前端芯片基本概念

1.1.2 射频前端芯片系统结构

1.1.3 射频前端芯片组成器件

1.2 射频前端芯片的工作原理

1.2.1 接收电路工作原理

1.2.2 发射电路工作原理

1.3 射频前端芯片产业链结构

1.3.1 射频前端产业链

1.3.2 射频芯片设计

1.3.3 射频芯片代工

1.3.4 射频芯片封装

第二章 2016-2020年射频前端芯片行业发展环境分析

2.1 政策环境

2.1.1 主要政策分析

2.1.2 网络强国战略

- 2.1.3 相关优惠政策
- 2.1.4 相关利好政策
- 2.2 经济环境
 - 2.2.1 宏观经济发展概况
 - 2.2.2 工业经济运行情况
 - 2.2.3 经济转型升级态势
 - 2.2.4 未来经济发展展望
- 2.3 社会环境
 - 2.3.1 移动网络运行状况
 - 2.3.2 研发经费投入增长
 - 2.3.3 科技人才队伍壮大
- 2.4 技术环境
 - 2.4.1 无线通讯技术进展
 - 2.4.2 5G技术迅速发展
 - 2.4.3 氮化镓技术现状

第三章 2016-2020年射频前端芯片行业发展分析

- 3.1 全球射频前端芯片行业运行分析
 - 3.1.1 行业需求状况
 - 3.1.2 市场发展规模
 - 3.1.3 市场份额占比
 - 3.1.4 市场核心企业
 - 3.1.5 市场竞争格局
- 3.2 2016-2020年中国射频前端芯片行业发展状况
 - 3.2.1 行业发展历程
 - 3.2.2 产业商业模式
 - 3.2.3 市场发展规模
 - 3.2.4 市场竞争状况
- 3.3 中国射频前端芯片行业竞争壁垒分析
 - 3.3.1 实现工艺难度大
 - 3.3.2 厂商模组化方案
 - 3.3.3 基带厂商话语权

3.4 5G技术发展背景下射频前端芯片的发展潜力

3.4.1 5G技术性能变化

3.4.2 5G技术手段升级

3.4.3 射频器件模组化

3.4.4 国产化发展路径

第四章 2016-2020年中国射频前端细分市场发展分析

4.1 2016-2020年滤波器市场发展状况

4.1.1 滤波器基本概述

4.1.2 滤波器市场规模

4.1.3 滤波器竞争格局

4.1.4 滤波器发展前景

4.2 2016-2020年射频开关市场发展状况

4.2.1 射频开关基本概述

4.2.2 射频开关市场规模

4.2.3 射频开关竞争格局

4.2.4 射频开关发展前景

4.3 2016-2020年功率放大器（PA）市场发展状况

4.3.1 射频PA基本概述

4.3.2 射频PA市场规模

4.3.3 射频PA竞争格局

4.3.4 射频PA发展前景

4.4 2016-2020年低噪声放大器（LNA）市场发展状况

4.4.1 LNA基本概述

4.4.2 LNA市场规模

4.4.3 LNA竞争格局

4.4.4 LNA发展前景

第五章 2016-2020年氮化镓射频器件行业发展分析

5.1 氮化镓材料基本概述

5.1.1 氮化镓基本概念

5.1.2 氮化镓形成阶段

- 5.1.3 氮化镓性能优势
- 5.1.4 氮化镓功能作用
- 5.2 氮化镓器件应用现状分析
 - 5.2.1 氮化镓器件性能优势
 - 5.2.2 氮化镓器件应用广泛
 - 5.2.3 硅基氮化镓衬底技术
- 5.3 氮化镓射频器件市场运行分析
 - 5.3.1 市场发展状况
 - 5.3.2 行业厂商介绍
 - 5.3.3 市场发展空间

第六章 中国射频前端芯片产业链重要环节发展剖析

- 6.1 射频前端芯片设计
 - 6.1.1 芯片设计市场发展规模
 - 6.1.2 芯片设计企业发展状况
 - 6.1.3 芯片设计产业地域分布
 - 6.1.4 射频芯片设计企业动态
 - 6.1.5 射频芯片设计技术突破
- 6.2 射频前端芯片代工
 - 6.2.1 芯片代工市场发展规模
 - 6.2.2 芯片代工市场竞争格局
 - 6.2.3 射频芯片代工市场现状
 - 6.2.4 射频芯片代工企业动态
- 6.3 射频前端芯片封装
 - 6.3.1 芯片封装行业基本介绍
 - 6.3.2 芯片封装市场发展规模
 - 6.3.3 射频芯片封装企业动态
 - 6.3.4 射频芯片封装技术趋势

第七章 射频前端芯片应用领域发展状况

- 7.1 智能移动终端
 - 7.1.1 智能移动终端运行状况

- 7.1.2 智能移动终端竞争状况
- 7.1.3 移动终端射频器件架构
- 7.1.4 5G手机射频前端的机遇
- 7.1.5 手机射频器件发展前景
- 7.2 通讯基站
 - 7.2.1 通讯基站市场发展规模
 - 7.2.2 5G基站的建设布局加快
 - 7.2.3 5G基站对射频前端需求
 - 7.2.4 基站射频器件竞争格局
 - 7.2.5 5G基站的建设规划目标
- 7.3 路由器
 - 7.3.1 路由器市场运行状况
 - 7.3.2 路由器市场竞争格局
 - 7.3.3 路由器细分产品市场
 - 7.3.4 路由器芯片发展现状
 - 7.3.5 5G路由器产品动态

第八章 国外射频前端芯片重点企业经营状况

- 8.1 Skyworks
 - 8.1.1 企业基本概况
 - 8.1.2 企业经营状况
 - 8.1.3 业务布局分析
 - 8.1.4 企业发展动态
 - 8.1.5 未来发展前景
- 8.2 Qorvo
 - 8.2.1 企业基本概况
 - 8.2.2 企业经营状况
 - 8.2.3 业务布局分析
 - 8.2.4 企业发展动态
 - 8.2.5 未来发展前景
- 8.3 Broadcom
 - 8.3.1 企业基本概况

- 8.3.2 企业经营状况
- 8.3.3 业务布局分析
- 8.3.4 企业发展动态
- 8.3.5 未来发展前景
- 8.4 Murata
- 8.4.1 企业基本概况
- 8.4.2 企业经营状况
- 8.4.3 业务布局分析
- 8.4.4 企业发展动态
- 8.4.5 未来发展前景

第九章 国内射频前端芯片重点企业经营状况

- 9.1 紫光展锐
- 9.1.1 企业发展概况
- 9.1.2 经营效益分析
- 9.1.3 业务经营分析
- 9.1.4 财务状况分析
- 9.1.5 核心竞争力分析
- 9.1.6 公司发展战略
- 9.2 汉天下
- 9.2.1 企业发展概况
- 9.2.2 经营效益分析
- 9.2.3 业务经营分析
- 9.2.4 财务状况分析
- 9.2.5 核心竞争力分析
- 9.2.6 公司发展战略
- 9.3 卓胜微
- 9.3.1 企业发展概况
- 9.3.2 经营效益分析
- 9.3.3 业务经营分析
- 9.3.4 财务状况分析
- 9.3.5 核心竞争力分析

9.3.6 公司发展战略

9.4 三安光电

9.4.1 企业发展概况

9.4.2 经营效益分析

9.4.3 业务经营分析

9.4.4 财务状况分析

9.4.5 核心竞争力分析

9.4.6 公司发展战略

9.5 长电科技

9.5.1 企业发展概况

9.5.2 经营效益分析

9.5.3 业务经营分析

9.5.4 财务状况分析

9.5.5 核心竞争力分析

9.5.6 公司发展战略

第十章 中国射频前端芯片行业投资价值综合分析

10.1 2016-2020年射频芯片行业投融资状况

10.1.1 行业投资规模

10.1.2 行业融资需求

10.1.3 投资项目分析

10.1.4 企业布局动态

10.2 射频前端芯片投资壁垒分析

10.2.1 政策壁垒

10.2.2 竞争壁垒

10.2.3 资金壁垒

10.2.4 技术壁垒

10.3 射频前端芯片投资价值分析

10.3.1 行业投资机会

10.3.2 行业进入时机

10.3.3 投资策略建议

第十一章 2022-2028年中国射频前端芯片行业发展趋势和前景预测分析 ()

11.1 射频前端芯片发展前景展望

11.1.1 手机射频前端发展潜力

11.1.2 基站射频前端空间预测

11.1.3 射频前端市场空间测算

11.2 2022-2028年射频前端芯片行业发展预测

11.2.1 2022-2028年射频前端芯片影响因素分析

11.2.2 2022-2028年射频前端芯片市场规模预测

部分图表目录：

图表 射频电路方框图

图表 智能终端通信系统结构示意图

图表 部分射频器件功能简介

图表 射频前端结构示意图

图表 射频开关工作原理

图表 声表面波滤波器（SAW）原理图

图表 体声波滤波器（BAW）原理图

图表 SAW与BAW适用频率范围

图表 射频低噪声放大器工作原理

图表 功率放大器工作原理

图表 双工器工作原理

图表 接收电路方框图

图表 发射电路方框图

图表 射频前端产业链图谱

图表 5G产业主要政策

图表 我国移动通信技术演进情况

图表 射频前端市场竞争格局

图表 射频组件和供应链模块核心公司

图表 全球射频前端市场格局

图表 射频前端行业模式示意图

图表 Fabless 模式下产业链分工

图表 SAW滤波器实现原理

图表 BAW滤波器实现原理

图表 滤波器主要厂商的产品线与类型

图表 射频前端产业链模组化趋势

图表 主要射频厂商模组化方案

图表 4G到5G的主要技术指标差异点

图表 5G的三大场景（eMBB、mMTC与uRLCC）

图表 载波聚合技术原理、特点和实现形式

图表 具有4x4 MIMO的3下行链路CA

图表 CA的进步

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202209/318532.html>